

## **Materialwissenschaftler diskutieren neue Lösungsansätze zur Steigerung der Leistungsfähigkeit integrierter Schaltkreise**

***IHP organisiert internationale dreitägige Konferenz in Bad Saarow***

**Frankfurt (Oder), 20. Juni 2008:** Vom 23. bis 25. Juni 2008 findet in Bad Saarow der 15. europäische Workshop "Dielektrika in der Mikroelektronik" (WoDiM 2008) statt. 150 Wissenschaftler aus 29 Ländern Europas, Asiens, Amerikas und Afrikas nehmen daran teil und präsentieren in über 40 Vorträgen und 90 Posterbeiträgen ihre neuesten Forschungsergebnisse. Die Organisation dieser internationalen Konferenz, die alle zwei Jahre in Europa stattfindet, liegt beim IHP.

Anliegen der WoDiM 2008 ist es, neueste Forschungsergebnisse zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit integrierter Schaltkreise vorzustellen, die mit der Verringerung der Abmessungen wesentlicher Bauelemente wie Transistoren und Kondensatoren verbunden sind. Da mit der Verkleinerung dieser Bauelemente auch die in ihnen enthaltenen isolierenden Schichten immer dünner werden und schließlich nicht mehr isolieren, müssen alternative Materialien mit besseren dielektrischen Eigenschaften gefunden werden und zum Einsatz kommen. Solche Materialien sind geeignet, Durchbrüche in der zukünftigen siliziumbasierten Nanoelektronik zu ermöglichen. Die WoDiM 2008 stellt eine stimulierende internationale Plattform für den Austausch physikalischer und technologischer Konzepte, Methoden und Techniken zwischen Wissenschaftlern dar, die anwendungsorientiert auf Forschungsgebieten dielektrischer Materialien für siliziumbasierte integrierte Schaltkreise arbeiten.

„Mit der Entscheidung des internationalen WoDiM-Komitees, das IHP mit der Ausrichtung der 15. Konferenz zu betrauen, werden auch die Forschungsergebnisse des IHP auf diesem Gebiet gewürdigt“ sagt Prof. Dr. Hans-Joachim Müssig, Abteilungsleiter für Materialforschung am IHP und Organisator der WoDiM 2008. Und weiter: „Als Ausdruck für die Industrierelevanz der Konferenz kann die Tatsache gewertet werden, dass zahlreiche Firmen diese Veranstaltung auch finanziell unterstützen und damit erst ermöglichen“.

Weitere Hinweise finden Sie auch unter: <http://www.wodim2008.de>

### **Ansprechpartner:**

IHP  
Heidrun Förster  
Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit  
Tel: 0335 5625 204  
Fax: 0335 5625 222  
Email: [foerster@ihp-microelectronics.com](mailto:foerster@ihp-microelectronics.com)

Tagungsbüro „WoDiM 2008“  
Prof. Dr. Hans-Joachim Müssig  
Hotel Esplanade, Bad Saarow  
Tel: 03361 432 0